

产品概述

华彩威新一代数字LED专为高清图像应用开发，每个通道高达16bit灰度数据。非常适合大型显示屏图像显示。

高度集成的数字LED外部不需要包括电容在内的任何电子元件。

数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的48bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少48bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

主要特点

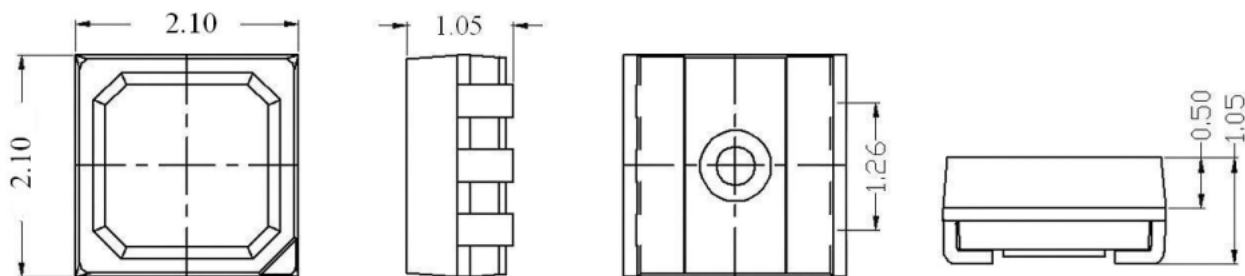
- 0.6uA级静态电流，超低静态功耗，超低电压恒流。
- IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个2121封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- OUT R/G/B 输出灰度等级：65536级。
- 端口扫描频率4KHz。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 2.1mm*2.1mm*1mm（高度）超小尺寸。
- 内部IC高度集成，具有反接保护功能。

主要应用领域

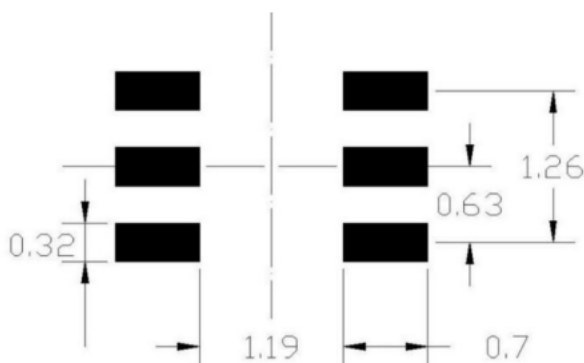
- LED透明屏，LED像素屏，LED异形屏，各种电子产品。

机械尺寸（单位mm）

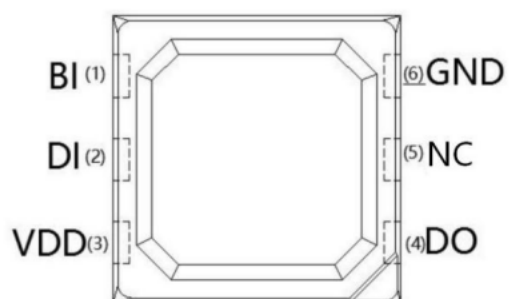
公差：±0.15 mm



推荐焊盘尺寸



引出端排列



引脚功能

引脚位	符号	管脚名	功能描述
1	BI	辅助信号输入	辅助信号输入引脚
2	DI	主路信号输入	主路信号输入引脚
3	VDD	电源	供电引脚
4	DO	主路信号输出	控制信号输出引脚
5	NC	空脚	引脚悬空
6	GND	地	信号接地和电源接地引脚

最大额定值（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	范围	单位
电源电压	V_{DD}	+3.3~+5.5	V
逻辑输入电压	V_I	-0.3V~ $V_{DD}+0.7$	V
工作温度	T_{opt}	-40~+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度(散料)	T_{stg}	-40~+105	$^{\circ}\text{C}$
储存温度(整卷)	T_{stg}	-40~+70	$^{\circ}\text{C}$

电气参数（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
静态电流	I_o	—	0.6	1	μA	无信号传输，RGB通道关闭
端口输出电流	I_{out}	—	9	—	mA	OUTR/OUTG/OUTB
输入电流	I_I	—	—	± 1	μA	$V_I=V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入电压	V_{IH}	$0.55V_{DD}$	—	—	V	D_{IN} , SET
低电平输入电压	V_{IL}	-0.3V	—	$0.3 V_{DD}$	V	D_{IN} , SET
滞后电压	V_H	—	0.35	—	V	

开关特性（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	t_{PLZ}	—	—	300	ns	$CL=15\text{pF}$, $D_{IN} \rightarrow D_{OUT}$, $RL=10\text{K}\Omega$
下降时间	t_{THZ}	—	—	120	μs	$CL=300\text{pF}$, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容	C_I	—	—	15	pF	—

LED 特性参数

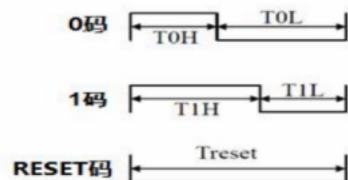
参数	符号	颜色	测试条件: $V_{DD}=5\text{V}$			
			最小值	典型值	最大值	单位
发光强度	IV	Red	250	—	350	mcd
		Green	600	—	850	
		Blue	100	—	140	
波长	λ_d	Red	618	—	628	nm
		Green	513	—	523	
		Blue	465	—	475	
发光角度			—	120	—	Deg

数据传输时间

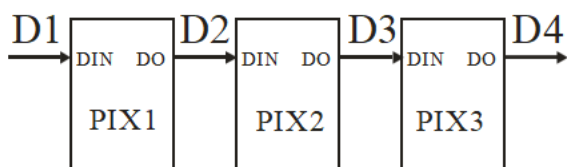
T0H	0 码, 高电平时间	200ns~320ns
T1H	1 码, 高电平时间	520ns~800ns
T0L	0 码, 低电平时间	800ns~1.2μs
T1L	1 码, 低电平时间	480ns~1μs
RES	帧单位, 低电平时间	280μs 以上
数据周期: $T0H+T0L \geq 1.25\mu s$; $T1H+T1L \geq 1.25\mu s$		

时序波形图

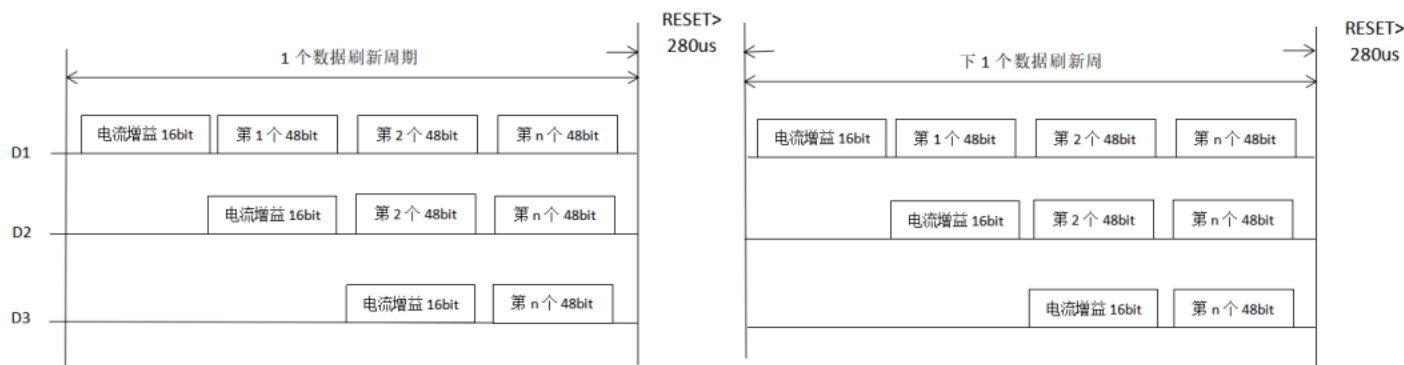
输入码型:



连接方法:



数据传输方法



注: 其中D1为MCU端发送的数据, D2、D3为级联电路自动整形转发的数据。

数据结构

- 16bit电流增益数据结构, 高位先发, 按照GRB顺序发送。

IG4	IG3	IG2	IG1	IG0	IR4	IR3	IR2	IR1	IR0	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0	校验码
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

注: 校验码发0或1均可

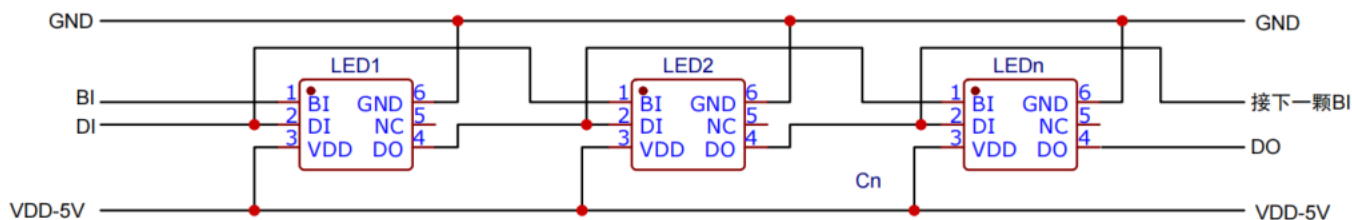
- 48bit RGB灰度数据结构, 高位先发, 按照GRB顺序发送。

G15	G14	G13	G12	G11	G10	G9	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	...接下...			
...接上...		R15	R14	R13	R12	R11	R10	R9	R8	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	...接下...	
...接上...		B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		

电流增益

电流增益设置	RGB电流 (mA)
0	0
1	0.28
2	0.56
3	0.84
4	1.16
5	1.45
6	1.72
7	2.01
8	2.36
9	2.65
A	2.92
B	3.20
C	3.51
D	3.80
E	4.07
F	4.34
10	4.79
11	5.07
12	5.34
13	5.61
14	5.92
15	6.20
16	6.47
17	6.74
18	7.08
19	7.36
1A	7.62
1B	7.89
1C	8.20
1D	8.48
1E	8.73
1F	9.00

典型应用电路

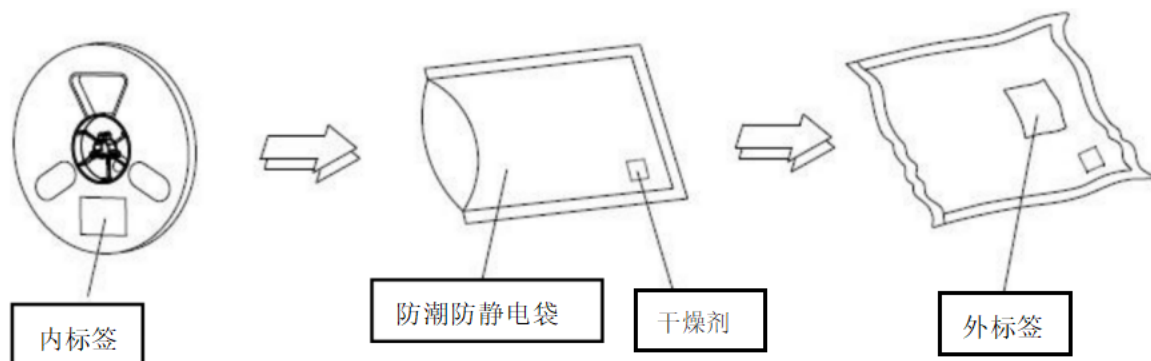


说明:

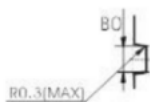
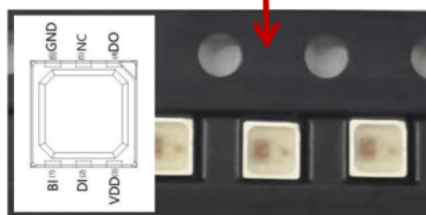
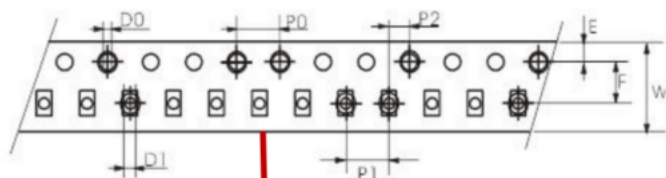
1. DI 是主输入信号, BI 是辅助输入信号。正常情况下, LED 从 DI 提取信号; 当中间某一颗 LED 损坏时, 后一颗 LED 从 BI 提取信号, 不影响后面 LED 的信号传输。

2. 成品应用时, 第一颗 LED 的 BI 引脚不可悬空, 建议接 GND。

包装方式及数量： 4000PCS /袋



载带规格及 LED 编带位置

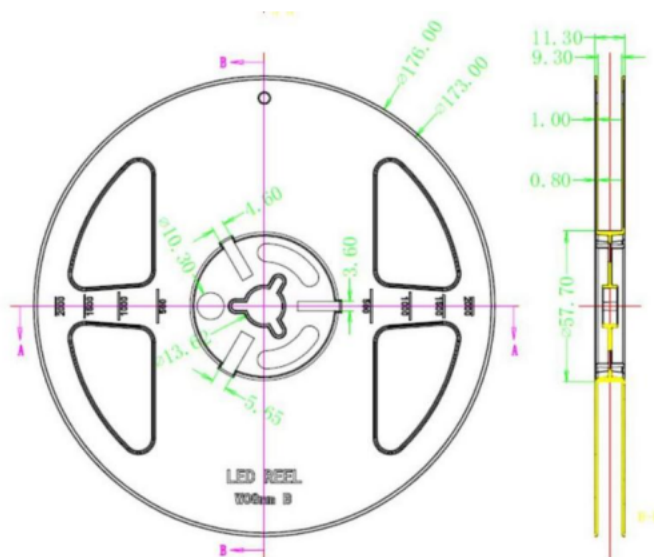


UNIT:MM

SYMBOL	SPEC
B0	2.35±0.1
P0	4.00±0.1
P1	4.00±0.1
P2	2.00±0.1
T	0.18±0.1
E	1.75±0.1
F	3.50±0.1
D0	1.50±0.1
D1	1.00±0.1
W	8.00±0.1
10P0	40.00±0.2

卷轴尺寸

单位：mm



表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法，为了让客户更好地使用华彩威 电子的 LED 产品，请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项

2.1. 灰尘与清洁 LED 的表面是采用改性环氧胶封装的，环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘，保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃，也不会影响到发光亮度，但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用，安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中，

在 LED 表面需要清洁时，如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象，不可使用具用溶解性的溶液清洁 LED，可使用一此异丙基的溶液，在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用；请不要用超声波的方法清洁 LED，如果产品必须使用超声波，那么就要评估影响 LED 的一些参数 • 如超声波功率，烘烤的时间和装配的条件等，在清洁之前必须试运行，确认是否会影响 LED

2.2. 防潮包装

TOP SMD LED 属于湿敏元件，将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气，在包装袋中放有干燥剂，以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气，那么在 LED 过回流焊时，水气就会蒸发而膨胀，有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因，防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气。此款产品防潮等级为：LEVEL5a 表一：IPC/JEDEC J-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义

防潮等级	包装拆封后车间寿命	
	时间	条件
LEVEL1	无限制	≤30℃/85%RH
LEVEL2	1 年	≤30℃/60%RH
LEVEL2a	4 周	≤30℃/60%RH
LEVEL3	168 小时	≤30℃/60%RH
LEVEL4	72 小时	≤30℃/60%RH
LEVEL5	48 小时	≤30℃/60%RH
LEVEL5a	24 小时	≤30℃/60%RH
LEVEL6	取出即用	≤30℃/60%RH

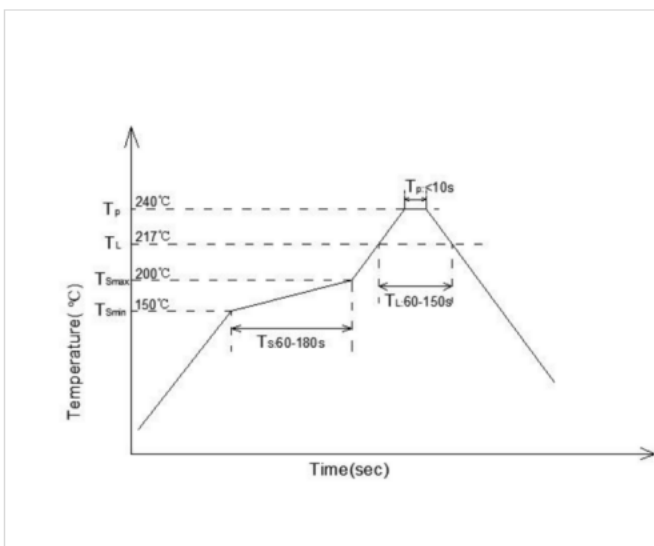
2.3 SMT 贴片说明:

- 2.3.1 LED在SMT前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（70~75℃烘烤 $\geq$ 24H）；
- 2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在24H内（在T<30℃，RH<60%条件下）；
- 2.3.3 LED贴片在印刷锡膏后的PCBA上，应尽快完成SMT，建议不超过1H；
- 2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤：70~75℃* $\geq$ 24H 或 散料烘烤：120℃*4H。

3. 回流焊接

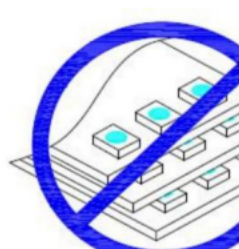
经过用下面所列参数检测证明，表面贴装型 LED 符合 JEDEC J-STD-020C 标准。作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐使用的焊接温度曲线。

温度曲线描述	无铅回流焊
最低预热温度(Tsmin)	150℃
最高预热温度(Tsmax)	200℃
预热区时间(Tsmin to Tsmax) (ts)	60-180 S
平均升温速率(Tsmax to Tp)	<3℃/S
液相温度(TL)	217℃
液相区保温时间(tL)	60-150 S
峰值温度(Tp)	240℃
高温区停留时间(tp)	<10 S
降温速率	<6℃/S
室温至峰值温度停留时间	<6 min



- 注：1. 以上为一般指导原则可能并不适用于所有 PCB 设计和回流焊的配置
2. 所有温度是指在封装本体上表面测的温度

4. 产品配装过程注意事项

1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取	2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路	3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路	4. 不可用在 PH<7 的酸性场所
			



WORLDSEMI

文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建	20260822	陈永昭	尹华平